

2024年 4月 24日

委員各位殿

一般社団法人 溶接学会
マイクロ接合研究委員会
委員長 福本信次
(公印省略)

マイクロ接合研究委員会 開催通知

第145回マイクロ接合研究委員会を下記の通り開催致しますので、万障お繰り合せの上
ご出席下さいますようお願い申し上げます。

出欠は5月17日(金)までにお知らせ下さい

- 日時 2024年(令和6年) 5月 24日(金) 10:30～16:35
- 場所 大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 912+913会議室
東京都中央区日本橋本町二丁目3番11号 日本橋ライフサイエンスビルディング9階
- 幹事会のご案内
幹事会を12:00～開催いたしますので、幹事または代理の方はご出席下さいますようお願い申し上げます。会場は911会議室です。

【出欠・事務関連の連絡先】

一般社団法人溶接学会 事務局 木暮
E-mail: s_kogure@tt.rim.or.jp TEL: 03-5825-4073

第145回マイクロ接合研究委員会
プログラム

日時: 2024年 5月 24日(金) 10:30~16:35

場所: 大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913+912 会議室(東京 日本橋)

時間	題目	講演者
司会 岡本康寛 (岡山大学)		
10:30~11:15	『高輝度青色半導体レーザを用いた銅皮膜形成技術の開発』 (資料番号MJ-852-2024)	大阪大学 接合科学研究所 ○佐藤雄二, 塚本雅裕, 竹中啓輔
11:15~12:00	『長期保存電子部品のはんだ濡れ性改善に関する ギ酸処理再生技術』 (資料番号MJ-853-2024)	(株)日立製作所 ○依田智子, 関野崇, 皆川円, 藪内達志 山崎雅宏
12:00~13:00	昼食休憩	
13:00~13:10	委員会議事	
13:10~13:20	MJ賞表彰式	
司会 瀬知啓久 (東京プレイズ株式会社)		
13:20~14:05	Mate2024 受賞講演 『半導体パッケージの金属/樹脂界面における 剥離評価手法の研究』 (資料番号MJ-854-2024)	(株)東芝 ○松尾圭一郎, 久保悠, 山本哲也 東芝デバイス&ストレージ(株) 田摩京 鹿児島大学 大学院 池田徹
14:05~14:50	『量子コンピュータに向けた極低温チップ実装の取り組み』 (資料番号MJ-855-2024)	神戸大学 ○田口美里 (株)日立製作所 加藤薫子, 楠野順弘 神戸大学 三木拓司, 永田真
14:50~15:05	休憩	
司会 瀬知啓久 (東京プレイズ株式会社)		
15:05~15:50	『大面積電ビーム照射による Al-Cu 合金の 陽極酸化被膜特性向上』 (資料番号MJ-856-2024)	岡山大学 学術研究院 ○篠永東吾, 岡田晃 岡山大学 大学院 宮本郁也, 瀬部彩乃
15:50~16:35	『コールドスプレー法による金属多孔質膜の成膜と 金属/樹脂接合への応用』 (資料番号MJ-857-2024)	東北大学 大学院 ○鴫田駿, 佐藤裕 岩手県工業技術センター 桑島孝幸, 園田哲也, 佐々木龍徳

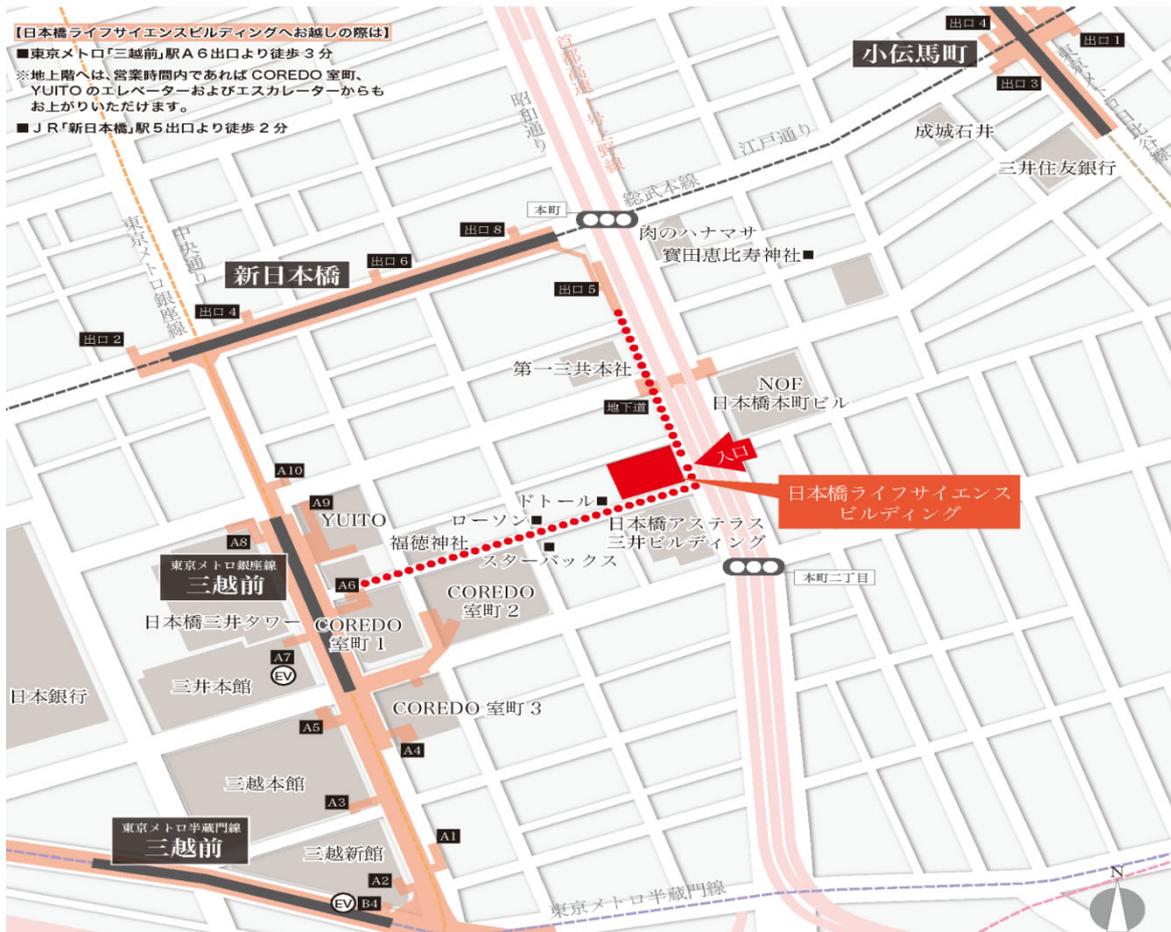
※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

4. 配付資料について

当日の配布資料は委員会開催前にダウンロードシステムを利用し皆様へご送付致します。
開催当日までにご自身にて印刷を行っていただきご準備のうえご参加をお願いいたします。

✓配付資料は各自でご持参ください。会場に紙資料のご用意はございません。

(案内図)



アクセス

- ・東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅A6出口より徒歩3分
- ・JR総武本線「新日本橋」駅 5番出口より徒歩2分
- ・JR各線「神田」駅 南口より徒歩 11分
- ・JR各線「東京」駅 新日本橋口より徒歩 17分